

5

Date of Dispatch: April 25, 2006

NOTICE OF REJECTION

Patent Application No.: 2006-06261

Cited Documents:

1. JP Laid-Open Patent/Utility Publication No:H11-0162889 ✓
2. JP Laid-Open Patent/Utility Publication No:S61-121453 ✓
3. JP Laid-Open Patent/Utility Publication No:2003-338467 ✓

整理番号 2005-1042  
発送番号 172497  
発送日 平成18年 4月25日

FP03-0042  
44  
46.  
270  
278

# 拒絶理由通知書

特許出願の番号 特願2006-016261  
起案日 平成18年 4月21日  
特許庁審査官 加藤 昌人 9257 3P00  
特許出願人代理人 長谷川 芳樹 (外 2名) 様  
適用条文 第39条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

## 理由

この出願の下記の請求項に係る発明は、同一出願人が同日出願した下記の出願の発明と同一と認められるから、この通知書と同日に発送した特許庁長官名による別紙指令書に記載した届出がないときは特許法第39条第2項の規定により特許を受けることができない。

## 記

- ・請求項：1～4
- ・備考

シートを拡張させることによって、一つ一つの部品に切断することは、例えば特開平11-162889号公報の段落0026、特開昭6-1121453号公報の第2頁右上欄下から5行目～同頁左下欄第13行等に示すように、この出願前周知の技術である。

またマトリクス状に配置された複数の機能素子が表面に形成された半導体基板は、引用文献を示すまでもなく周知の技術である。

よって、本願の原出願である特願2002-351600号(特開2003-338467号)の請求項6に記載された発明と、実質的に同一である。

また、拒絶理由が解消しない場合は、先願が未確定であっても拒絶査定を行うので、留意されたし。

なお、

(1) 補正は、この出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項のほか、出願当初の明細書又は図面に記載した事項から自明な事項の範囲内で行わなければならない。

(2) 特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明とは、整合性が取れるように注意すること(例えば、特許請求の範囲の補正によって、出願当初は実施例であった記載が参考例になった場合など)。

(3) 補正の際には、補正箇所を下線を引き(特許法施行規則様式第13備考6)、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張されたい(意見書の記載形式は、無効審判における訂正請求書の記載形式を参考にされたい)。

## 先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 IPC B23K26/00-26/42  
H01L21/301  
DB名
- ・先行技術文献

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

- ・出願人(法人にあっては法人の代表権を有する者)、又は担当弁理士による、この拒絶理由についての問合せ先  
特許審査第二部 特殊加工 加藤昌人

BEST AVAILABLE COPY

TEL:03-3581-1101 (内線 3362-4)